

公告本

申請日期	89. 8. 24
案 號	89117025
類 別	GobK 19/00

A4
C4

(以上各欄由本局填註)

發 明 專 利 說 明 書		480448						
一、發明 新型名稱	中 文	記憶卡						
	英 文	"メモ리카ード"						
二、發明 創作人	姓 名	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 中西 清二</td> <td style="width: 50%;">4. 阪本 孝廣</td> </tr> <tr> <td>2. 鳥居 高志</td> <td>5. 矢野 正義</td> </tr> <tr> <td>3. 古田 敬明</td> <td></td> </tr> </table>	1. 中西 清二	4. 阪本 孝廣	2. 鳥居 高志	5. 矢野 正義	3. 古田 敬明	
1. 中西 清二	4. 阪本 孝廣							
2. 鳥居 高志	5. 矢野 正義							
3. 古田 敬明								
	國 籍	均日本						
	住、居所	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>1. 日本國大阪府四條畷市田原台1丁目3-25</td></tr> <tr><td>2. 日本國大阪府大阪市城東區關目4-2-2-605</td></tr> <tr><td>3. 日本國滋賀縣大津市青山1-6-15</td></tr> <tr><td>4. 日本國大阪府枚方市川原町2-30</td></tr> <tr><td>5. 日本國大阪府枚方市伊加賀榮町11-12</td></tr> </table>	1. 日本國大阪府四條畷市田原台1丁目3-25	2. 日本國大阪府大阪市城東區關目4-2-2-605	3. 日本國滋賀縣大津市青山1-6-15	4. 日本國大阪府枚方市川原町2-30	5. 日本國大阪府枚方市伊加賀榮町11-12	
1. 日本國大阪府四條畷市田原台1丁目3-25								
2. 日本國大阪府大阪市城東區關目4-2-2-605								
3. 日本國滋賀縣大津市青山1-6-15								
4. 日本國大阪府枚方市川原町2-30								
5. 日本國大阪府枚方市伊加賀榮町11-12								
三、申請人	姓 名 (名稱)	日商松下電器產業股份有限公司						
	國 籍	日本						
	住、居所 (事務所)	日本國大阪府門真市大字門真1006番地						
	代 表 人 姓 名	中村 邦夫						

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

裝 訂 線

(由本局填寫)

承辦人代碼：
大類：
I P C 分類：

A6
B6

本案已向：

國(地區) 申請專利，申請日期： 案號： 有 無主張優先權

日本 1999年08月24日 特願平11-236734 有 無主張優先權

有關微生物已寄存於： 寄存日期： 寄存號碼：

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

五、發明說明(1)

[發明之領域]

本發明與一種具備防止誤消除記憶內容或重寫之可否寫入設定機構之記憶卡有關。

[發明之背景]

先前記憶卡之可否寫入設定機構，有使用反射片、開關或露出本體許多之設定鍵者。

圖12係具備藉反射片33操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡1100透視圖。圖12中31係記憶卡本體，32係一體設在記憶卡本體31之端子，33係反射片。

記憶卡本體31內部包括半導體記憶體(未圖示)，可重寫內容。藉該半導體記憶體與端子32以電連接之機器(未圖示)，讀取或重寫記憶於半導體記憶體之資料。此例、可否寫入設定機構使用反射片33。將反射片33張貼或剝離記憶卡本體31之一定位置，以設定可否寫入。前述機器，以光電耦合器等檢測記憶卡本體31之一定位置反射狀態，以檢測其設定。

圖13係具備藉開關43操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡1200透視圖。圖13中41係記憶卡本體，42係一體設在記憶卡本體41之端子，43係開關。

記憶卡本體41內部包括半導體記憶體(未圖示)，可重寫內容。藉該半導體記憶體與端子42以電連接之機器(未圖示)，讀取或重寫記憶於半導體記憶體之資料。此例、可否寫入設定機構使用開關43。以開關43之轉換可設定可否寫入。前述機器，藉端子42以電檢測開關43之設定。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(2)

此種記憶卡要求記憶卡本體之小型化、薄型化及可否寫入設定操作之簡便化之並存。

具備藉反射片33操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡1100，未具可否寫入設定機構用之機械構造。故對記憶卡本體31之小型化、薄型化有效。惟因以反射片33張貼與剝離設定可否寫入，故可否寫入設定操作不便。

又具備藉開關43操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡1200，因以開關43之轉換設定可否寫入，故可否寫入設定操作簡便。惟因記憶卡本體41內藏開關，故記憶卡本體41之小型化、薄型化有限。

本發明之目的為提供具備設定操作簡便，記憶卡本體可小型化、薄型化之可否寫入設定機構之記憶卡。

發明之概述

本發明有關之記憶卡包含：記憶卡本體，形成缺口部；半導體記憶體，至少可寫入資料；端子，設在該記憶卡本體並以電連接該半導體記憶體與外部機器；及可否寫入設定鍵，滑動自如嵌合於該缺口部並設定該資料可否寫入該半導體記憶體；其特徵為：該記憶卡本體含上本體與下本體，該上本體與該下本體之至少一方，具有形成在該缺口部內側之彈性導溝，該可否寫入設定鍵係滑動自如嵌合於該彈性導溝，並被夾持於該上本體與該下本體間，該可否寫入設定鍵配置成其一部分覆蓋該缺口部之一部分，該可否寫入設定鍵設定該資料可否寫入該半導體記憶體，對該彈性導溝滑動，該彈性導溝具有卡合部，俾卡止該可否寫

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(3)

入設定鍵以選擇該可否寫入設定鍵對該彈性導溝之位置，由此可達成上述目的。

前述卡合部包含凸部，卡止前述可否寫入設定鍵形成，前述可否寫入設定鍵係越過該凸部，卡止於前述彈性導溝兩側中之任一，以選擇覆蓋前述可否寫入設定鍵缺口部之位置亦可。

前述卡合部包含第1卡合部，由凸部或凹部形成，前述可否寫入設定鍵包含第2卡合部，由凹部或凸部形成，前述可否寫入設定鍵係將該第2卡合部卡止於該第1卡合部，以選擇覆蓋前述可否寫入設定鍵缺口部之位置亦可。

前述上本體與前述下本體之一方，具有形成在前述彈性導溝內側之縫隙，前述可否寫入設定鍵與該縫隙嵌合亦可。

前述可否寫入設定鍵包括：操作部，具有覆蓋前述缺口部實施可否寫入設定，並以手動轉換用鍵之功能；止拔部，與前述縫隙嵌合；及滑動接觸部，連接該操作部與該止拔部並接觸滑動於前述彈性導溝；亦可。

前述上本體與前述下本體之另一方，具有形成在前述縫隙相對位置之凹溝，前述可否寫入設定鍵與該縫隙及該凹溝嵌合亦可。

前述上本體與前述下本體之一方，具有標籤張貼區，張貼標籤以覆蓋前述縫隙亦可。

前述上本體與前述下本體之至少一方，具有凹溝，與前述可否寫入設定鍵嵌合形成亦可。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(4)

前述上本體與前述下本體，分別具有凹溝，與前述可否寫入設定鍵嵌合形成亦可。

前述記憶卡更包含開關，設於該記憶卡本體內部並以電轉換該資料之可否寫入用，該開關包含運轉部，對該開關突出前述可否寫入設定鍵側設置，該運轉部隨前述可否寫入設定鍵之滑動，以電轉換該資料之可否寫入亦可。

前述記憶卡更包含接點，設於該記憶卡本體內部並以電轉換該資料之可否寫入，前述可否寫入設定鍵包含接片，設於對應該接點之位置亦可。

前述記憶卡更包含印刷基板，安裝前述半導體記憶體，前述接點係形成於該印刷基板上亦可。

前述彈性導溝形成前述接片接觸前述接點時，藉該彈性導溝之彈力從前述接片向前述接點方向作用亦可。

前述上本體與前述下本體，於前述缺口部內側形成滑動孔，前述彈性導溝包含溝，形成於前述滑動孔內部前述上本體與前述下本體之至少一方，前述可否寫入設定鍵包含嵌合部，插入該滑動孔並與該溝嵌合，該嵌合部具有最大寬度部，具有以前述上本體與前述下本體之彈性變形可將該嵌合部插入該滑動孔程度之比該滑動孔寬度大之寬度，前述卡合部係形成於該溝內亦可。

前述嵌合部前端部具有比前述滑動孔寬度小之寬度，前述嵌合部具有傾斜面，從該前端部向前述最大寬部傾斜，將前述可否寫入設定鍵裝於前述記憶卡本體時，該傾斜面推開前述滑動孔，使前述可否寫入設定鍵插入該滑動孔與

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(5)

該溝嵌合亦可。

圖式之簡單說明

圖1係依照本發明第1實施形態之記憶卡組合狀態下面側透視圖。

圖2係剖開同下本體一部分之透視圖。

圖3係同一部分分解狀態之上面側透視圖。

圖4係剖開同上本體一部分之透視圖。

圖5係同圖1之A-A斷面圖。

圖6係同可否寫入設定鍵之操作說明圖。

圖7係同可否寫入設定鍵之設定檢測說明圖。

圖8係本發明第2實施形態之記憶卡斷面圖。

圖9係本發明第3實施形態之記憶卡斷面圖。

圖10係本發明第4實施形態之記憶卡斷面圖。

圖11係實施形態5之具備可否寫入設定鍵之部分斷面圖。

圖12係具備藉反射片操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡透視圖。

圖13係具備藉開關操作之可否寫入設定機構之先前之記憶卡透視圖。

較佳實施例之詳細說明

(實施形態1)

以下用圖說明本發明之第1實施形態。

圖1係依照本發明第1實施形態之記憶卡100之組合狀態下面側透視圖，圖2係剖開記憶卡100下本體一部分之透視

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(6)

圖，圖3係記憶卡100之一部分分解狀態之上面側透視圖，圖4係剖開記憶卡100之上本體一部分之透視圖，圖5係圖1之A-A斷面圖，圖6(a)、(b)係記憶卡100之可否寫入設定鍵之操作說明圖，圖7(a)、(b)係記憶卡100之可否寫入設定鍵之設定檢測說明圖。

圖1~圖5中、1係記憶卡上本體，2係記憶卡下本體，由重疊2片上下本體1、2構成記憶卡本體51，茲將上本體1之寬度形成比下本體2為寬。3係設在寬度大之記憶卡上本體1側部之缺口部，於記憶卡上本體1之平面形狀形成矩形凹缺，將可否寫入設定鍵4滑動自如配置於缺口部3構成。即在缺口部3內側記憶卡上本體1設縫隙5形成之彈性導溝6，又於縫隙5相對位置之記憶卡下本體2設溝7，將可否寫入設定鍵4滑動自如嵌合於縫隙5及溝7與彈性導溝6，並將可否寫入設定鍵4夾持於記憶卡上下本體1、2間構成。而可否寫入設定鍵4配置成其一部分臨記憶卡上本體1之缺口部3，覆蓋缺口部3之一部分，以其滑動選擇覆蓋缺口部3之位置。

可否寫入設定鍵4覆蓋缺口部3實施可否寫入設定，包括：操作部4a，實施其設定用手動轉換用鍵；止拔部4b，嵌合於縫隙5及溝7；及滑動接觸部4c，連接前述操作部4a與止拔部4b並接觸滑動於彈性導溝6。而可否寫入設定鍵4嵌合於形成縫隙5之記憶卡上本體1，並被形成溝7之記憶卡下本體2覆蓋，將止拔部4b嵌合於縫隙5與溝7，成為滑動接觸部4c可滑動被夾持於彈性導溝6與記憶

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(7)

卡下本體2間之狀態。

設在記憶卡上本體1之彈性導溝6，其略中央部形成凸部6a而成之卡合部，可否寫入設定鍵4之滑動接觸部4c騎過凸部6a分別卡止於彈性導溝6兩側，以選擇可否寫入設定鍵4覆蓋缺口部3之位置。即形成記憶卡上本體1之彈性導溝6與可否寫入設定鍵4間，設置對彈性導溝6卡止可否寫入設定鍵4之滑動位置用卡合部之形態。由此可使其具有可否寫入設定鍵4之滑動之點擊(卡塔)感與可否設定之卡止，由改變凸部6a之凸量可調整點擊感。茲由凸部6a而成之卡合部，於彈性導溝6形成凸部或凹部而成之第1卡合部，於可否寫入設定鍵4之滑動接觸部4c之彈性導溝6對應面形成凹部或凸部而成之第2卡合部，由可否寫入設定鍵4之滑動將第2卡合部卡止於第1卡合部，以構成亦可。又只要分別為卡脫自如之構造，則各形狀並不受此限制。

於記憶卡本體一體設有將機器以電連接於形成在記憶卡本體2側之縫隙8部分用之端子9，又其內部具有基板11俾安裝可重寫內容之半導體記憶體10。半導體記憶體10從藉端子9以電連接之機器(未圖示)，讀取與重寫記憶內容。茲關於重寫，為了防止誤消除記憶內容或寫上，具備後述可否寫入設定機構。

12係標籤張貼區，以凹狀形成在記憶卡上本體1表面上，如圖5所示、將印有該記憶卡之一定顯示項目之標籤12a張貼於標籤張貼區12。茲將可否寫入設定鍵4之止拔部4b形成稍微不突出縫隙5之端緣，即可具有防止標籤

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · 訂 · 線

五、發明說明(8)

12a之剝落效果，並將記憶卡下本體2之凹溝7不形成縫隙狀而形成溝狀，縫隙5側因張貼標籤12a不損導向性而消除可視部之凹凸，而可構成不損及觀瞻之構造。

以下說明如以上構成之記憶卡之作用。

將可否寫入設定鍵4夾持於記憶卡上下本體51時，與安裝半導體記憶體10之基板11同時，以記憶卡上本體1與記憶卡下本體2夾持。茲可否寫入設定鍵4以於記憶卡上下本體1、2間被縫隙5與彈性導溝6與凹溝7導向之形態，被夾持於一定位置，並以焊接或黏接缺口部3以外之記憶卡上本體1與記憶卡下本體2之外週。

如此，被夾持於記憶卡上下本體1、2之可否寫入設定鍵4，其操作部4a覆蓋缺口部3之一部分。如圖6(a)、(b)所示，被覆蓋之部分為缺口部3左右任何一方之約一半，圖6(a)係覆蓋左側，被覆蓋之部分與記憶卡上本體1之外形略成一體。未被覆蓋之右側約一半於記憶卡本體之平面形狀形成矩形凹缺。由向右滑動可否寫入設定鍵4，可否寫入設定鍵4之滑動接觸部4c騎過彈性導溝6上之凸部6a，被覆蓋部分如圖6(b)被卡止於彈性導溝6右側，惟騎過時邊使彈性導溝6撓曲實施。由可否寫入設定鍵4之滑動，選擇覆蓋缺口部3之位置，以設定資料可否寫入該記憶卡。

資料可否寫入該記憶卡之設定操作，以手指按操作部4a向左右滑動可否寫入設定鍵4實施。此時、可否寫入設定鍵4以凸部6a邊騎過彈性導溝6卡脫，可帶適度點擊感使其滑動，並防止可否寫入設定鍵4意外滑動。又缺口部3不

五、發明說明(9)

被可否寫入設定鍵4覆蓋之矩形凹缺兼具指示器功能，可明確視辨可否寫入資料之設定狀態。又茲於可否寫入設定鍵4之操作部4a兩角部設有段部4d，於覆蓋缺口部3之一方與記憶卡上本體1側面緣之間形成微小凹部，使手指或爪之卡止容易。

其次、用圖7(a)、(b)說明插入連接記憶卡之機器檢測記憶卡之可否寫入設定之方法。

圖7(a)中、22係本實施形態之插入連接記憶卡之機器，21係設在機器22之檢測開關，包括檢測部23與接點24。茲可否寫入設定鍵4與圖6(a)同樣，覆蓋缺口部3左側，以可否寫入設定鍵4位於左方位置狀態為可寫入設定。於可寫入設定，因可否寫入設定鍵4覆蓋缺口部3左側，故檢測開關21之檢測部23被抬上，關閉接點24。由檢測接點24之關閉，機器22可辨認可寫入記憶卡。

一方面、圖7(b)所示可否寫入設定鍵4於右方位置狀態為不可寫入設定。於不可寫入設定，因缺口部3左側不被可否寫入設定鍵4覆蓋，故檢測開關21之檢測部23不被抬上，而接點24開啓，由檢測接點24之開啓，機器22可辨認無法寫入記憶卡。

(實施形態2)

其次、用圖8說明本發明之第2實施形態。圖8係本發明第2實施形態之開關內藏記憶卡斷面圖。

基本構造與實施形態1相同。如圖8所示、構成將開關13裝於記憶卡內部之基板11上，並使開關13之運轉部13a

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明 (10)

突出可否寫入設定鍵4側。一方面、於可否寫入設定鍵4設操作部4e，將操作部4e可卡合於開關13之運轉部13a配置構成。故在記憶卡上本體1與記憶卡下本體2間，設操作部4e與運轉部13a滑動或移動之空間14。由此種構造，因可否寫入設定鍵4滑動之可否寫入之同時，可於記憶卡本體內部以電轉換。

(實施形態3)

其次，用圖9說明本發明之第3實施形態。圖9係本發明第3實施形態之接點部內藏記憶卡斷面圖。

基本構造與實施形態1相同。如圖9所示、將接點15設於記憶卡內部之基板11上，並於可否寫入設定鍵4設接片保持部4f及接片4g，並在記憶卡上本體1與記憶卡下本體2間，設接片保持部4f及接片4g滑動空間16，因可否寫入設定鍵4滑動之可否寫入之同時，可以電轉換。

(實施形態4)

其次、用圖10說明本發明之第4實施形態。圖10係本發明第4實施形態之具備記憶卡之可否寫入設定鍵4之部分斷面圖。

基本構造與實施形態1相同。如圖10所示、本實施形態係於該部分形成凹溝17，以代替於實施形態1之記憶卡上本體1形成縫隙5者，將可否寫入設定鍵4之止拔部4b嵌合於凹溝17與形成於記憶卡下本體2之凹溝7者。

以上說明各實施形態有關縫隙5之大小、凹溝7或17之深度、又彈性導溝6之厚度、凸部6a之高度等，得與構成

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(11)

記憶卡上下本體1、2及可否寫入設定鍵4之合成樹脂等材料之材質相依，隨滑動時之彈性強度、點擊感等設定適當加以設定。

(實施形態5)

參考圖11說明實施形態5。圖11係實施形態5之具備記憶卡之可否寫入設定鍵之部分斷面圖。

記憶卡上下本體1、2係於缺口部3內側，依記憶卡上下本體1、2形成滑動孔18，並於滑動孔18內部之記憶卡上下本體1、2形成溝19、20。溝19、20具有利用記憶卡上下本體1、2彈性變形之彈性導向之功能。記憶卡上下本體1、2預先以超音波焊接等，如圖11所示、接合成一體。由其接合、於缺口部3內側形成側面方向開放之滑動孔18。溝20內形成卡合部21。卡合部21具有後述可否寫入設定鍵4滑動時之定位功能。

可否寫入設定鍵4具有被插入形成在記憶卡上下本體1、2之滑動孔18，與溝19、20嵌合之嵌合部4h。嵌合部4h之最大寬度部4j之寬度D2比滑動孔18之寬度D1為大。嵌合部4h前端部4k之寬度D3比滑動孔18之寬度D1為小。嵌合部4h具有前端部4k向最大寬度部4j傾斜之傾斜面4m。

如圖11所示、可否寫入設定鍵4向箭示A1方向強制插入滑動孔18，與溝19、20嵌合。與溝19、20嵌合時，傾斜面4m推開彈性材製記憶卡上下本體1、2形成之滑動孔18，邊使記憶卡上下本體1、2彈性變形邊插入，嵌合部

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝
訂
線

五、發明說明(12)

4h與溝19、20嵌合。

嵌合後、與前述實施形態之記憶卡同樣，形成於溝19、20內之卡合部21定可否寫入設定鍵4之位置。

[產業上之可利用性]

如以上依本發明，構成將可否寫入設定鍵滑動自如嵌合於設在記憶卡本體側部之缺口部，由可否寫入設定鍵之滑動選擇覆蓋缺口部之位置，以設定可否寫入之構造，側部未具任何突起物保持卡片之薄型狀，僅以移動可否寫入設定鍵之簡便操作，即可改變缺口部設定可否寫入，且可將可否寫入設定鍵確實保持於記憶卡本體。又因將缺口部與可否寫入設定鍵設在記憶卡本體側部，即可加大能內藏半導體記憶卡等之有效面積比率，形成小型之記憶卡整體。

又能以簡單之形狀變更，於記憶卡本體內設置可否寫入設定用開關或接點部，具有記憶卡整體構造之自由度。此外、因將缺口部與可否寫入設定鍵設在記憶卡本體側部，即可加大能內藏半導體記憶卡等之有效面積比率，形成小型之記憶卡整體。

圖號說明

- 1... 記憶卡上本體
- 2... 記憶卡下本體
- 3... 缺口部
- 4... 可否寫入設定鍵
- 5... 縫隙
- 6... 彈性導溝

五、發明說明(13)

7...溝

8...縫隙

9...端子

10...半導體記憶體

11...基板

12...標籤張貼區

13...開關

15...接點

17...凹溝

18...滑動孔

19、20...溝

21...檢測開關(圖7(b))、卡合部(圖11)

22...插入記憶卡機器

23...檢測部

24...接點

51...記憶卡本體

100...記憶卡

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

四、中文發明摘要 (發明之名稱：記憶卡)

一種記憶卡，其包含：記憶卡本體，形成有缺口部；半導體記憶體，至少可寫入資料；端子，設在該記憶卡本體並以電連接該半導體記憶體與外部機器；及可否寫入設定鍵，滑動自如嵌合於該缺口部並設定該資料可否寫入該半導體記憶體；其特徵為：該記憶卡本體含上本體與下本體，該上本體與該下本體之至少一方具有形成在該缺口部內側之彈性導溝，該可否寫入設定鍵係滑動自如嵌合於該彈性導溝並被夾持於該上本體與該下本體間，該可否寫入設定鍵配置成其一部分覆蓋該缺口部之一部分，該可否寫入設定鍵對該彈性導溝滑動以設定該資料可否寫入該半導體記憶體，該彈性導溝具有卡合部俾卡止該可否寫入設定鍵以選擇該可否寫入設定鍵對該彈性導溝之位置。

英文發明摘要 (發明之名稱："メモリカード")

メモリカードは、切欠部が形成されるメモリカード本体と、データを少なくとも書き込み可能な半導体メモリと、該メモリカード本体に設けられ該半導体メモリと外部機器とを電氣的に接続する端子と、該切欠部に摺動自在に嵌合され該半導体メモリへの該データの書込可否を設定する書込可否設定子とを備え、該メモリカード本体は、上本体と下本体とを含み、該上本体と該下本体との少なくとも一方は、該切欠部の内側に形成された弾性ガイドを有し、該書込可否設定子は、該弾性ガイドに摺動自在に嵌合されると共に、該上本体と該下本体との間に挟持され、該書込可否設定子は、その一部が該切欠部の一部を覆うように配置され、該書込可否設定子は、該半導体メモリへの該データの書込可否を設定するように該弾性ガイドに対して摺動し、該弾性ガイドは、該弾性ガイドに対する該書込可否設定子の位置を選択するように該書込可否設定子を係止する係合部を有する。

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

六、申請專利範圍

1. 一種記憶卡，其包含：

記憶卡本體，形成缺口部；

半導體記憶體，至少可寫入資料；

端子，設在該記憶卡本體並以電連接該半導體記憶體與外部機器；及

可否寫入設定鍵，滑動自如嵌合於該缺口部並設定該資料可否寫入該半導體記憶體；其特徵為：

該記憶卡本體含上本體與下本體，

該上本體與該下本體之至少一方，具有形成在該缺口部內側之彈性導溝，

該可否寫入設定鍵係滑動自如嵌合於該彈性導溝，並被夾持於該上本體與該下本體間，

該可否寫入設定鍵配置成其一部分覆蓋該缺口部之一部分，

該可否寫入設定鍵對該彈性導溝滑動，以設定該資料可否寫入該半導體記憶體，

該彈性導溝具有卡合部，俾卡止該可否寫入設定鍵以選擇該可否寫入設定鍵對該彈性導溝之位置。

2. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中

前述卡合部包含凸部，卡止前述可否寫入設定鍵形成，

前述可否寫入設定鍵係越過該凸部，卡止於前述彈性導溝兩側中之任一，以選擇覆蓋前述可否寫入設定鍵缺口部之位置。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · · · · · 訂 · · · · · 線

六、申請專利範圍

3. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
 - 前述卡合部包含第1卡合部，由凸部或凹部形成，
 - 前述可否寫入設定鍵包含第2卡合部，由凹部或凸部形成，
 - 前述可否寫入設定鍵係將該第2卡合部卡止於該第1卡合部，以選擇覆蓋前述可否寫入設定鍵缺口部之位置。
4. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
 - 前述上本體與前述下本體之一方，具有形成在前述彈性導溝內側之縫隙，
 - 前述可否寫入設定鍵與該縫隙嵌合。
5. 如申請專利範圍第4項之記憶卡，其中前述可否寫入設定鍵包括：
 - 操作部，具有覆蓋前述缺口部實施可否寫入設定，並以手動轉換用鍵之功能；
 - 止拔部，與前述縫隙嵌合；及
 - 滑動接觸部，連接該操作部與該止拔部並接觸滑動於前述彈性導溝。
6. 如申請專利範圍第4項之記憶卡，其中
 - 前述上本體與前述下本體之另一方，具有形成在前述縫隙相對位置之凹溝，
 - 前述可否寫入設定鍵與該縫隙及該凹溝嵌合。
7. 如申請專利範圍第4項之記憶卡，其中
 - 前述上本體與前述下本體之一方，具有標籤張貼區，
 - 張貼標籤以覆蓋前述縫隙。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝 · · · · · 訂 · · · · · 線

六、申請專利範圍

8. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
前述上本體與前述下本體之至少一方，具有凹溝，與
前述可否寫入設定鍵嵌合形成。
9. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
前述上本體與前述下本體，分別具有凹溝，與前述可
否寫入設定鍵嵌合形成。
10. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
前述記憶卡更包含開關，設於該記憶卡本體內部並以
電轉換該資料之可否寫入用，
該開關包含運轉部，對該開關往前述可否寫入設定鍵
側突出設置，
該運轉部隨前述可否寫入設定鍵之滑動，以電轉換該
資料之可否寫入。
11. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中
前述記憶卡更包含接點，設於該記憶卡本體內部並以
電轉換該資料之可否寫入，
前述可否寫入設定鍵包含接片，設於對應該接點之位
置。
12. 如申請專利範圍第11項之記憶卡，其中
前述記憶卡更包含印刷基板，安裝前述半導體記憶
體，
前述接點係形成於該印刷基板上。
13. 如申請專利範圍第11或12項之記憶卡，其中
前述彈性導溝形成前述接片接觸前述接點時，藉該彈

六、申請專利範圍

性導溝之彈力從前述接片向前述接點方向作用。

14. 如申請專利範圍第1項之記憶卡，其中

前述上本體與前述下本體，於前述缺口部內側形成滑動孔，

前述彈性導溝包含溝，形成於前述滑動孔內部前述上本體與前述下本體之至少一方，

前述可否寫入設定鍵包含嵌合部，插入該滑動孔並與該溝嵌合，

該嵌合部具有最大寬度部，其乃以前述上本體與前述下本體之彈性變形可將該嵌合部插入該滑動孔之程度之比該滑動孔寬度大之寬度，

前述卡合部係形成於該溝內。

15. 如申請專利範圍第14項之記憶卡，其中

前述嵌合部前端部具有比前述滑動孔寬度小之寬度，

前述嵌合部具有傾斜面，從該前端部向前述最大寬部傾斜，

將前述可否寫入設定鍵裝於前述記憶卡本體時，該傾斜面推開前述滑動孔，使前述可否寫入設定鍵插入該滑動孔與該溝嵌合。

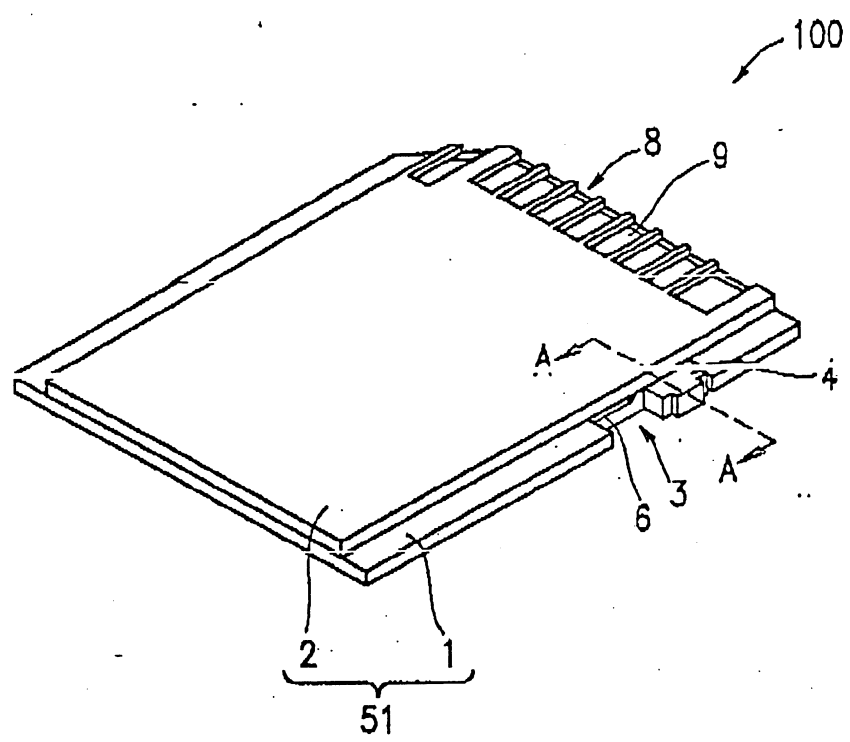


圖 1

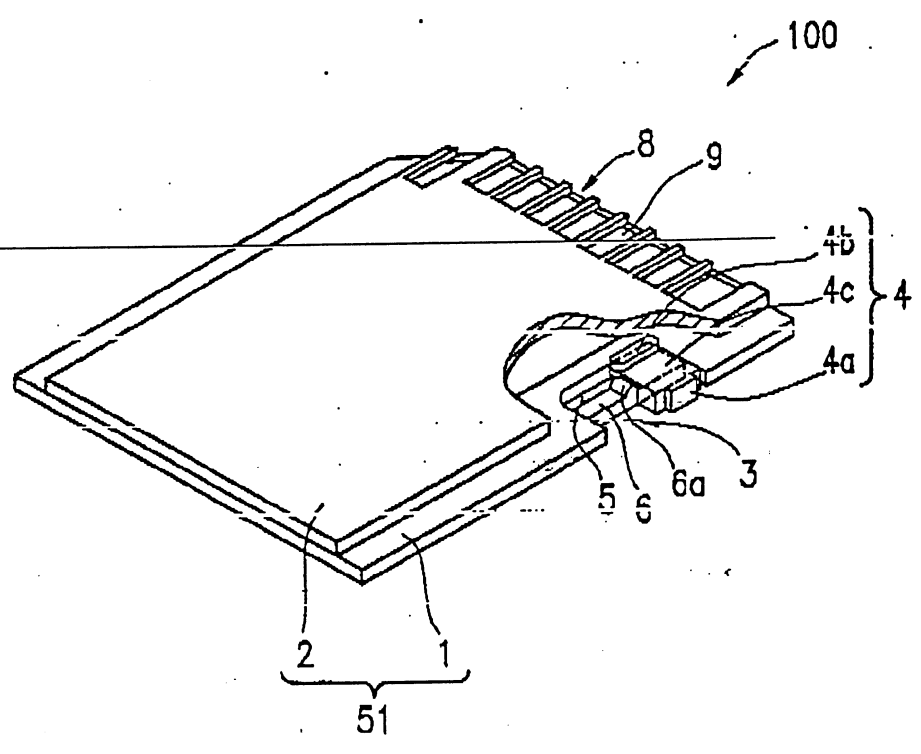


圖 2

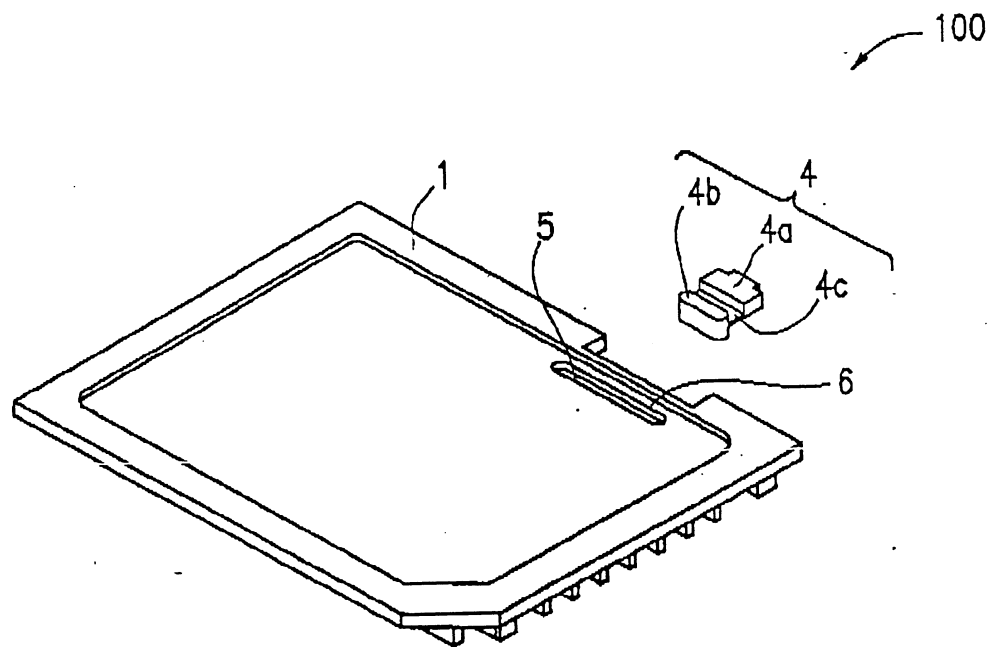


圖 3

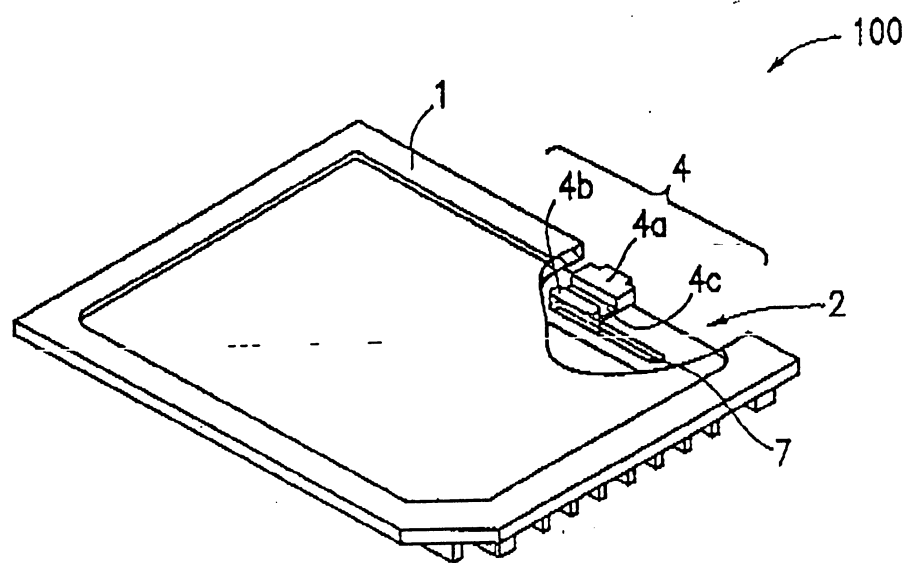


圖 4

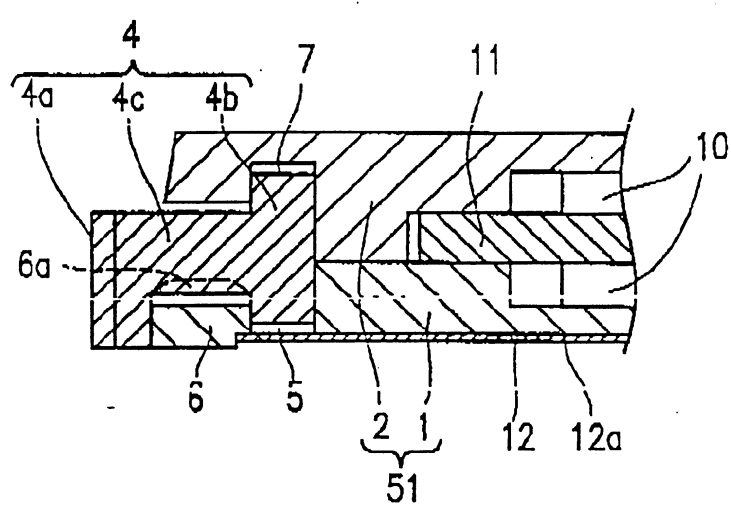


圖 5

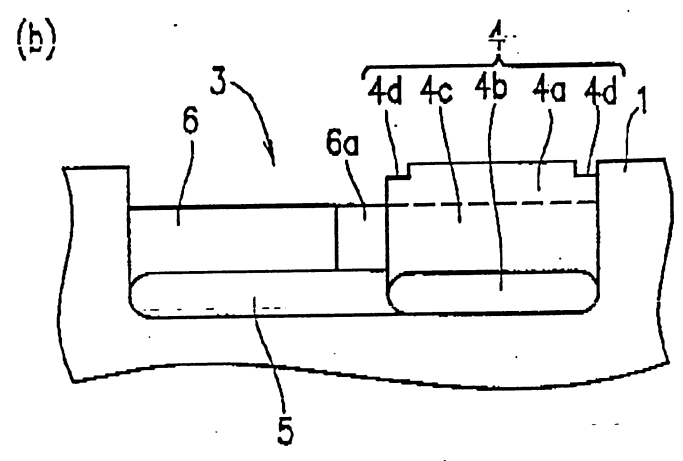
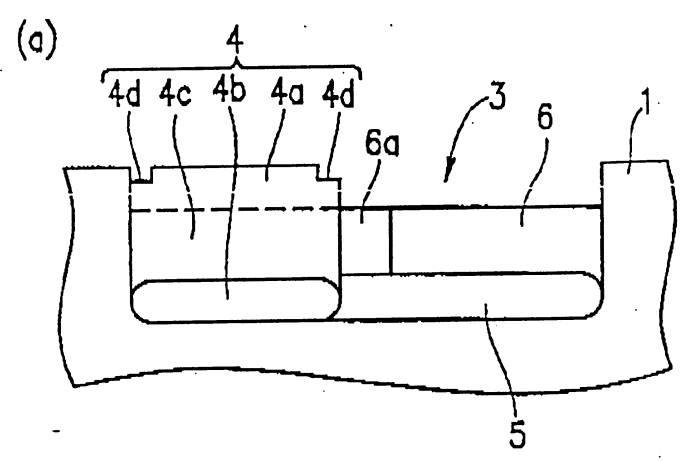


圖 6

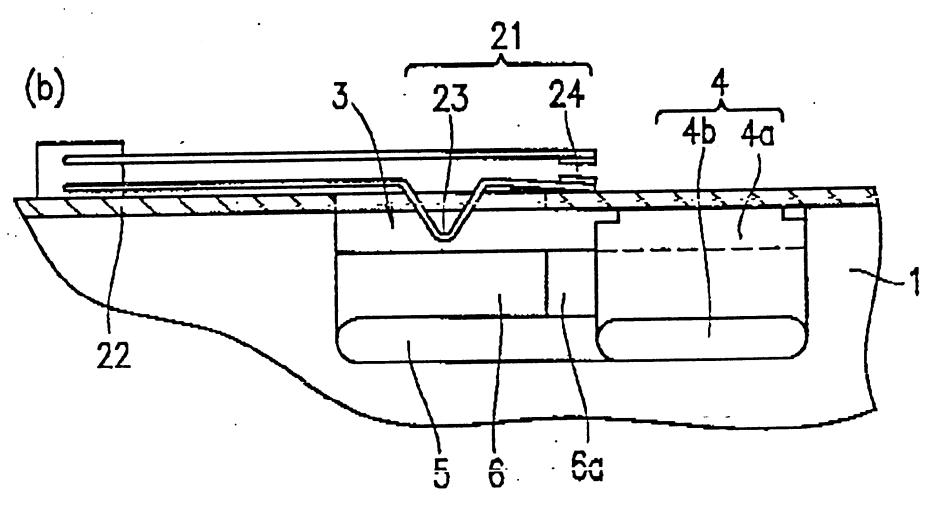
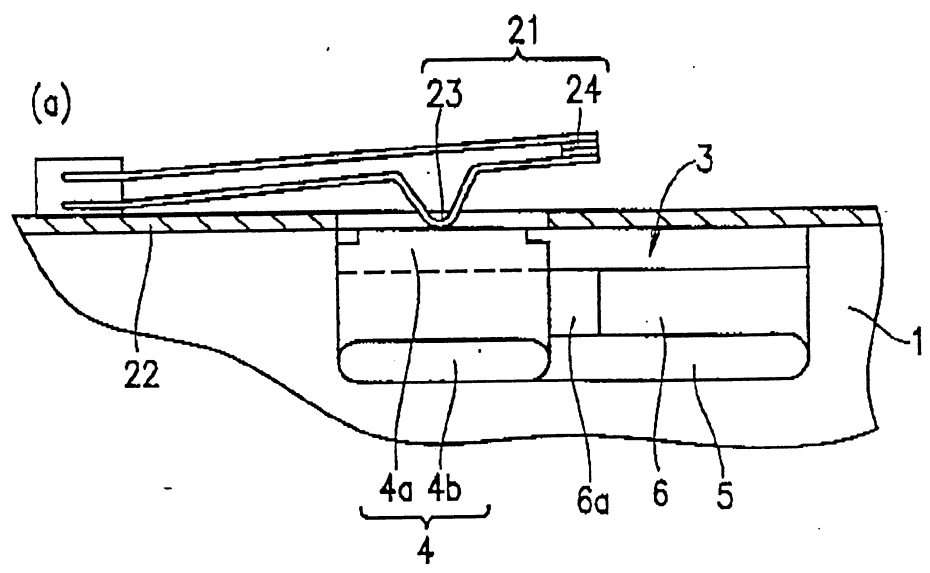


圖 7

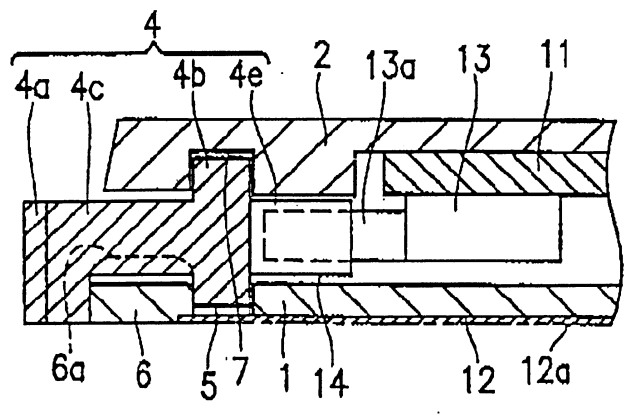


圖 8

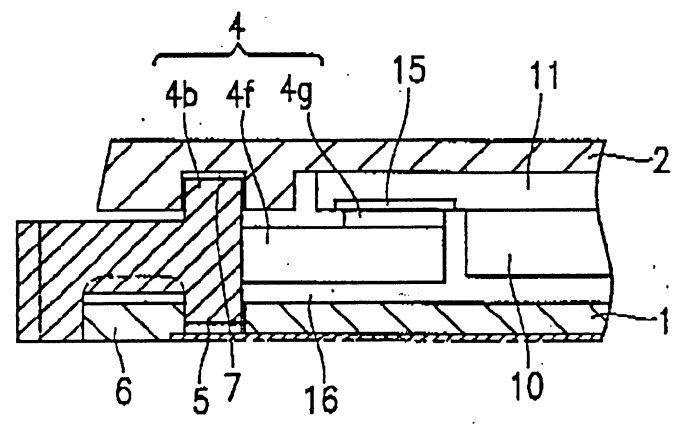


圖 9

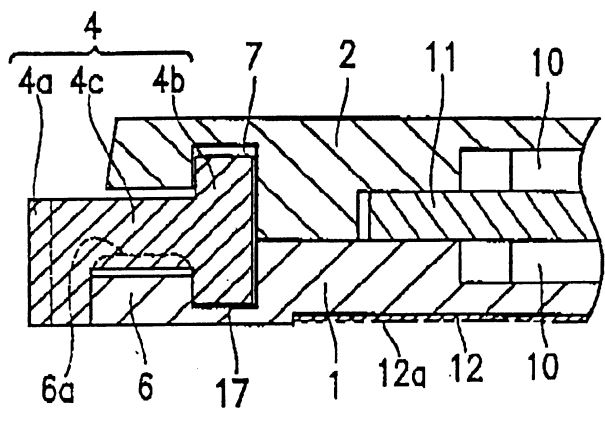


圖 10

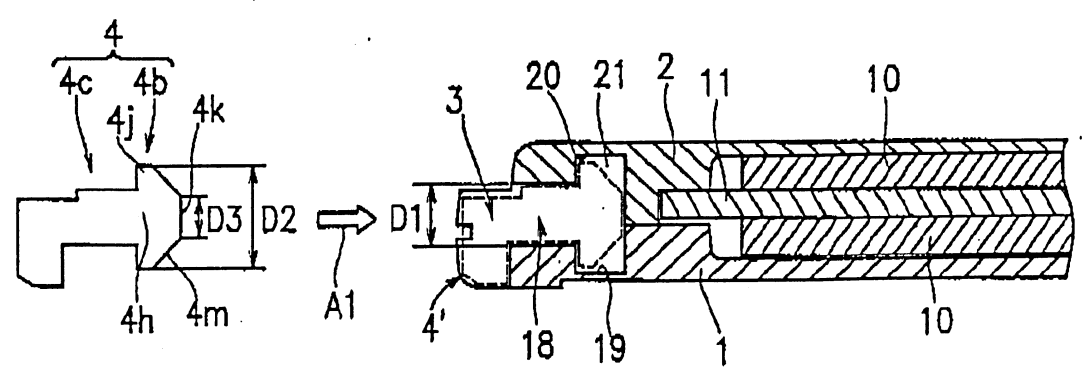


圖 11

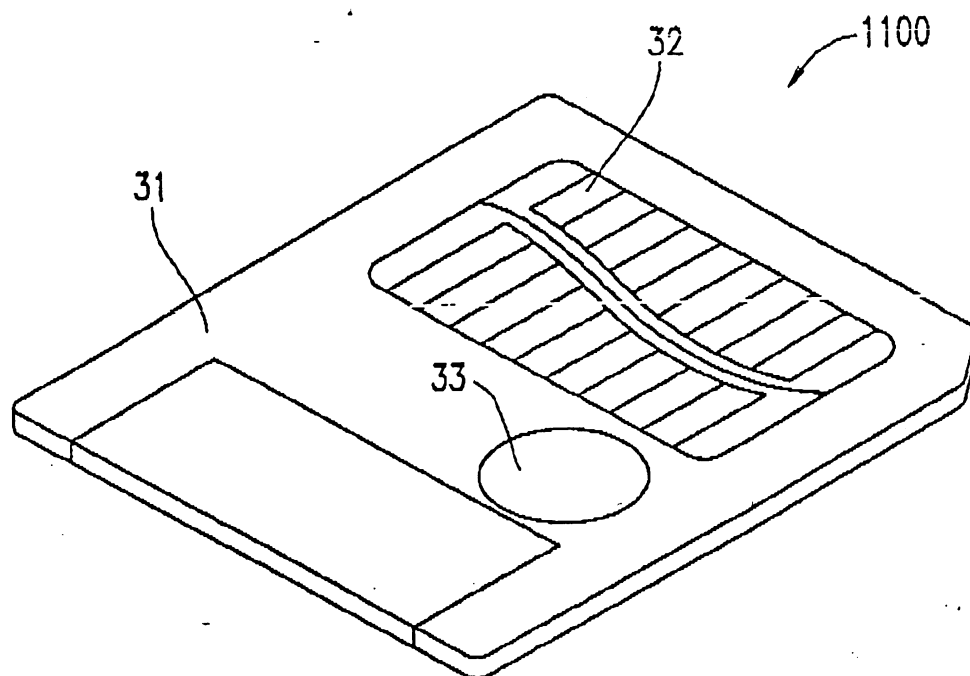


圖 12

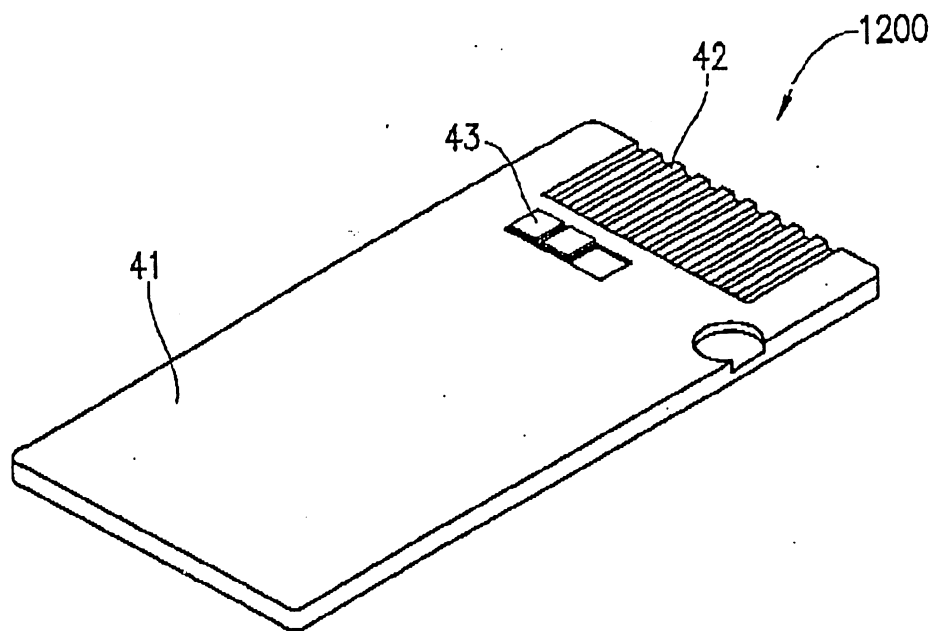


圖 13